LAGENAUFBAU HDI (Standard)

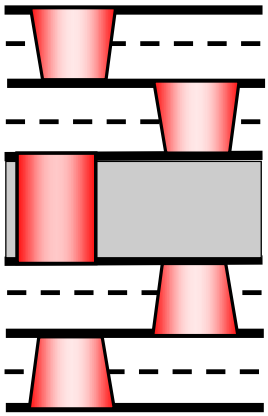
HDI06_2+2b+2_1,00

6 - Lagen

Kern: 0,61 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:	**2 + 2B + 2**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK2		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
3	VSK1			12 µm		35	
			0,610 mm			610	
4	RSK1			12 µm		35	
					1 x 1080	60	
5	RSK2			12 µm		30	
					1 x 1080	60	
6	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	
			1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 50 µm				
					Gesamtdicke Material:	1004	
					Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)		

MATERIALDICKE:	**1,00**	+/-	0,08	mm			Datum: / Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,08	+/-	0,11	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,14	+/-	0,13	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
05.01.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	05.01.2006	R. Schönholz	00	18+